



2020年1月吉日

関係各位

ISSM 組織委員会委員長
株式会社デバイス&システム・プラットフォーム開発センター
代表取締役会長 斎藤 昇三
ISSM 組織委員会副委員長
アトナープ株式会社
経営企画・品質担当シニアディレクター 井上 修一
ISSM 運営委員委員長
東芝ナノアナリシス株式会社
取締役技師長 嶋崎 綾子

第 28 回半導体生産技術国際シンポジウム「ISSM2020」協賛募金のお願いについて

拝啓 ますますご清祥の段、心よりお慶び申し上げます。

平素は、ISSM(半導体生産技術国際シンポジウム)にご厚情を賜りまして誠に有難うございます。

ISSM は皆様のご支援を賜り、これまでの 27 回の実績から半導体生産技術に関する最も重要な国際会議としての認知をいただき、半導体生産におけるメジャー会議としての位置づけを確立することができました。ISSM のテーマである半導体製造技術は、「作る技術」から「使う技術」へのシフトが益々重要となってきております。半導体製造技術全体を広く捉えて技術を評価し選択していくことが必要な今、ISSM は半導体製造全般の技術を網羅している特徴を活かし、異なる技術分野を統合化する体系的なアプローチを評価できる唯一の国際会議として ISSM は半導体製造の発展に一層寄与していきたいと考えます。半導体生産技術の新たな課題にむけて、半導体産業界の有益な協調を推し進め、延いては半導体産業の新たな飛躍に資すること、また半導体産業の永続的な発展と繁栄に資することを目指して ISSM2020 を開催致します。ISSM2020 は、2020 年 12 月 15 日(火)～16 日(水)に、KFC ホール(東京・両国)での開催を予定しております。

シンポジウムの開催は参加費にて運営されることが本来の姿と考え、参加者にとって魅力ある企画の推進に努めておりますが、半導体の将来を担う若手技術者並びに学生の参加を積極的に募るには、低めの参加費設定も必要と考えております。我が国の会議場費の高コスト構造などの事情を勘案しますと、経費の大幅な節減を行いましても、参加費のみでシンポジウムを開催することは至難な状況です。

ISSM2020 に何卒、ご支援を頂きたく、ご寄付(協賛募金)にご協力賜りたく、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

敬 具

ISSM2020

2020年12月15日(火)～16日(水)
KFCホール(両国)開催予定

開催趣意書

Version 1.4

ISSM2020 開催趣旨

ISSM(International Symposium on Semiconductor Manufacturing)は半導体基盤技術研究会(UCS)、IEEE EDS、SEMI(半導体製造装置・材料の国際的な工業会)の三者の共催の下、日米交互に毎年開催する成果発表会議として 1992 年に発足しました。2000 年からは半導体基盤技術研究会(UCS)に代わり応用物理学会の後援を受けております。発足理念は半導体の生産技術を体系化、普遍化された技術体系として構築することです。「ノウハウをサイエンスに」を合言葉に、グローバルな半導体生産技術者の議論・交流を通じて、新たな半導体生産技術の芽を育てると共に、生産技術のサイエンス化の新しい流れを作りだしてきました。2011 年からは e-Manufacturing & Design Collaboration Symposium とのコラボレーションで「A joint Symposium with ISSM」を隔年に台湾で開催しております。

半導体製品や技術をベースとする ICT (Information Communication Technology) やエネルギー・パワー関連技術は新しいナノ材料/エレクトロニクスと共に、グローバル社会のエネルギー、食糧、水、鉱物資源、環境制約などのメガトレンドを支え、さらなる変革・イノベーションに向けた広く、大きなアクションを採りつつあります。

それらに呼応する半導体産業のこの間の発展も目覚ましいものがあり、大きなうねりの中で、規模拡大のみならず効率的な産業構造や運営形態を求めて変化を遂げてきました。水平分業化型も垂直統合型も生産面では寡占ともいえる大規模生産能力を持つ少数企業への集約があり、また製品分野ごとにそれぞれのサイエンスとノウハウが異なり、生産が特化される形も顕著になってきています。

このことは短期的には、製品ごとの寡占化・分業化の進展ともあいまって、共通課題としての生産技術やそのノウハウを企業の枠を超えて技術者、研究者が議論し交流を持つことに、ある種の難しさを生じさせています。

しかし、一方では中核となる微細化技術やウエハ大口径化とそのプロセス技術も長足の進歩の末に翳りが見え始め、デバイス構造の三次元化、MEMS、新しいデバイス物理や新規な材料の導入、実装技術の高度化など、新しい方向や技術を生産の中でこなれたものにし、高い生産性を実現していく必要が出てきています。従来の6インチ、8インチなどのレガシーファブでの生産においても、新たな材料や設備の導入や新構造デバイスに向けたライン再構築、運営形態の進化等、可能性は広がっています。

自動運転や医療応用、広い環境下におかれる IoT とそのビッグデータ処理、人工知能やインフラのスマート化などでは、従来視点とは異なる極めて高い品質や信頼性、集積度、セキュリティー、センシング、解析・評価性能などが動作性能・コストと共に要求されます。前述の新しい方向と合わせて、製品設計技術との深い連携や、それら両面の技術難度の高さや深さ故に先を見た研究を喚起し取り込んでいくこと、すなわち関連産業を含めた個別企業間のみならず、学、公立研究機関との連携協力も様々なレベルで行っていく必要があります。共通の議論、交流の場の重要性が高まります。

さらには、関連産業において半導体デバイス生産には直接携わらないものの、半導体生産技術を中心に、そのノウハウとサイエンスを利用するニーズは高く、半導体関連産業全体の発展も見据えてそれを包括的に議論する場が求められております。

ISSM は「ノウハウをサイエンスに」の合言葉と共に、新たな役割を切り開くこと、すなわち生産活動目線をベースにしなが、幅広い産業・技術動向の俯瞰視点、少し高みからの経営視点を合わせ持つて、自ら将来を先取りした生産技術の方向や活動・運営を担う研究者・技術者が育ち、議論する場を提供していきたいと考えます。

中核技術者に加えて、次世代の若手半導体技術者の参加を強く期待いたしますとともに、半導体産業の永続的発展に貢献するために、ぜひ関係各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。

ISSM2020 大綱

1. 会議の名称

(和文名称) 第28回半導体生産技術国際シンポジウム 2020

(英文名称) International Symposium on Semiconductor Manufacturing 2020

(略称) ISSM2020

2. 主催機関などの名称(予定)

Co-sponsored by:

IEEE Electron Devices Society

Minimal Fab

Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ)

Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI)

Taiwan Semiconductor Industry Association (TSIA)

Endorsement by:

The Japan Society of Applied Physics

3. 会期と開催地(予定)

(1)会期:2020年12月15日(火)ー16日(水)

(2)開催地:KFCホール(東京・両国)

4. 会議の性格と目的

「開催趣旨」のとおり

5. ISSM2020 会議の概要

(ア) 会議日程 2020年12月15日(火)ー16日(水)

(イ) 会議内容(予定)

① キーノートセッション(基調講演)

② ハイライトセッション

③ オーラルプレゼンテーションセッション(一般講演)

④ インターラクティブ・ポスターセッション

⑤ チュートリアルセッション

(ウ) 会議の主題:半導体生産技術

① Fab Management

- ・ 工場設計および搬送自動化(FD)
- ・ 製造ラインの戦略及び運営管理(MS)
- ・ 生産管理および制御(MC)
- ・ 環境・安全・健康(ES)

② Process Integration

- ・ プロセスおよび材料の最適化(PO)
- ・ 歩留まり向上(YE)
- ・ 汚染防止及びウルトラクリーンテクノロジー(UC)
- ・ プロセス制御・モニタリング(PC)
- ・ 製造装置・測定装置(PE)
- ・ 生産性設計(DM)

③ Final Manufacturing

- ・ ファイナル・マニュファクチャリング(FM)

(エ) 参加予定国:日本, 米国, 欧州諸国, アジア諸国, その他

(オ) 参加予定者

日本, 欧米, アジアなどから200名

(カ) 会議公用語

講演 英語

印刷物 英語

ISSM2020 委員会組織 (敬称略)

組織委員会

ISSM組織委員会				
委員長	齋藤 昇三	株式会社デバイス&システム・プラットフォーム開発センター		代表取締役会長
副委員長	井上 修一	アトナーブ株式会社	経営企画・品質担当	シニアディレクター
会計委員長	上條 浩幸	東芝デバイス&ストレージ株式会社	先端ディスプレイ開発センター	センター長
運営兼務	堀岡 啓治	アプライドマテリアルズジャパン株式会社		技師長
	井上 道弘	国立研究開発法人産業技術総合研究所	九州産学官連携センター	イノベーションコーディネータ
	小池 淳義	サンディスク株式会社		代表取締役社長
	須原 忠浩	JSR株式会社	デジタルソリューション事業統括 担当	常務執行役員
運営兼務	奥野 泰利	株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ		シニア・テクノロジー・エグゼクティブ
運営兼務	松沢 貴仁	東京エレクトロン株式会社	システム開発センター AI開発プロジェクト	プロジェクトサプリダー
運営兼務	海本 博之	パナソニック株式会社		顧問
運営兼務	佐々木 智幸	パナソニック・タワージャズ セミコンダクター株式会社	プロセステクノロジーセンター所長	CTO
	清水 敦男	会津富士通セミコンダクター株式会社		執行役員 (製造担当)
	野崎 雅彦	ルネサス エレクトロニクス株式会社		執行役員常務 生産本部長
	西村 正			

運営委員会

ISSM運営委員会				
委員長	嶋崎 綾子	東芝アナナリス株式会社		取締役技師長
	堀岡 啓治	アプライドマテリアルズジャパン株式会社		Distinguished MTS, Research Advisor APTD SSG
	赤堀 浩史	キオクシア株式会社	四日市工場	副工場長
	内野 敏幸	株式会社KOKUSAI ELECTRIC	グローバルサービス統括本部	理事 本部長
	奥野 泰利	株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ		シニア・テクノロジー・エグゼクティブ
	中馬 宏之	成城大学	社会イノベーション学部 政策イノベーション学科	教授
	浜島 雅彦	SEMIジャパン		代表取締役社長
	売賀 賢介	株式会社デュラシステムズ		代表取締役社長
	服部 毅	国際ジャーナリスト テクニカルライター		国際ジャーナリスト テクニカルライター
	松沢 貴仁	東京エレクトロン株式会社	システム開発センター AI開発プロジェクト	プロジェクトサプリダー
	渡部 潔	一般社団法人日本半導体製造装置協会		専務理事
	海本 博之	パナソニック株式会社		顧問
	佐々木 智幸	パナソニック・タワージャズ セミコンダクター株式会社	プロセステクノロジーセンター所長	CTO
	石渡 直行	富士通セミコンダクター株式会社	ファンドリ支援統括部	部長 (兼務) 三重富士通セミコンダクター製造統括部 担当部長
	岡本 和也	山口大学大学院	技術経営研究科	教授・副研究科長
	森 啓之	ルネサス エレクトロニクス株式会社	前工程生産技術統括部 プロセス加工技術部	部長兼リソグラフィプロセス技術課課長
	島根 誉	ローム株式会社	WP生産本部 WP統括部	統括課長
	平山 誠			

プログラム委員会

プログラム委員会				
委員長	内野 敏幸	株式会社KOKUSAI ELECTRIC	理事 グローバルサービス	統括本部長
委員長代行	嶋崎 綾子	東芝ナノアナリス株式会社		取締役 技師長
委員長代行	今井 伸一	株式会社日立ハイテクノロジーズ	事業開発本部 本部長付	部長 工学博士
幹事会委員	加藤 凡典	イー・アイ・ティ		代表取締役
幹事会委員	小澤 克敏	オムロン株式会社	インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 企画室 IoTプロジェクト	部長
幹事会委員	南百瀬 勇	日本電産モビリティ株式会社	品質統括室	担当部長
	水野 晋介	アプライドマテリアルズジャパン株式会社	PDCプロダクトマネージメント	マネージャー
	青木 正身	ケーエルエー・テック株式会社	プロセス・コントロール・ソリューションズ	アジア・リージョナル・ディレクター
	赤石 実	オン・セミコンダクター	製造技術開発支援部	プロジェクトマネージャー
	新保 正博	オン・セミコンダクター	技術統括部 プロセス技術開発部	主任技術員
	山田 裕司	キオクシア株式会社	プロセス技術研究開発センター プロセス技術開発第三部	主査
	松川 和人	株式会社SUMCO	技術本部 カスタマー技術部	担当部長
	渡辺 健二	サンディスク株式会社	Fab MP Yield Mgmt	Sr. Principal Process Engineer
	村田 周平	JX金属株式会社	磯原工場 製品開発センター	主任技師
	久松 貴将	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社	長崎TEC MIS製品部門 デバイス技術1部 技術2課	統括課長
	有馬 澄佳	筑波大学	システム情報系 社会工学域 ファカルティシステム情報工学研究科	講師
	守屋 剛	東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社	新製品開発統括部 新製品プロジェクト	プロジェクトリーダー
	堀 洋一	東京応化工業株式会社	開発本部 先端材料開発一部	技士補
	井上 弘之	日本テキサス・インスツルメンツ株式会社	美浦ウエハーファブ プロダクトエンジニアグループ	TI上級主任技師 シニアプロフェッショナル
	安井 孝俊	パナソニック・タワー・ジャズセミコンダクター株式会社	プロセステクノロジーセンター プロセス技術開発部 イールドマネージメント開発課	主幹技師
	三宅 賢治	株式会社ピー・エムティー	経営企画室	室長
	根本 和典	Hitachi High Technologies America, Inc.	Corporate Strategy	VP
	樋谷 孝裕	ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社	製造統括部・設備技術部	
	横田 和樹	ルネサス エレクトロニクス株式会社	生産本部 デバイス開発統括部 プロセス技術部 プロセス技術第二課	課長
	竹井 祥司	ローム株式会社	LSI製造部 NVM技術課	技術員
	大地 宏明	ローム株式会社	LSI生産本部LSI製造部 微細加工プロセス課	技術主査

eMDC (e-Manufacturing & Design Collaboration Conference)/TSIA 協力メンバー

Name	Affiliation
Dr. Nicky C.C. Lu	Chairman & CEO, Etron Technology, Inc./Managing Board Director, TSIA
Dr. TY Wu	President, TSIA
Ms. Celia Shih	TSIA
Mr. Thomas Chen	tsmc
Mr. Robert Chien	tsmc
Dr. C. Hsu	tsmc
Prof. SC Chang	National Taiwan University
Prof. Argon Chen	National Taiwan University

【ISSM2020 協賛金特典内容】

	プラチナ	ゴールド	シルバー	ブロンズ
協賛金	¥800,000	¥600,000	¥400,000	¥200,000
ISSM2018 参加				
ISSM2020 への無料参加	6	4	2	1
ISSM2018 ログ掲載				
ISSM2020 ウェブサイト (ロゴから企業 HP へリンク)	上段	中段(上)	中段(下)	下段
予稿集に企業ロゴ掲載、ホームページへリンク	有	有	有	有
インターバルスクリーン上の企業ロゴを表示	有	有	有	有
会場ポスターに企業ロゴを表示	有	有	有	有
テーブルトップ展示				
テーブル・ホワイトボード	有	有	有	有

■ISSM 事務局

株式会社セミコンダクタポータル

〒106-0041 東京都港区麻布台 2-4-5 メソニック 39MT ビル4階

Tel: 03-5733-4971 Fax: 03-5733-4973 E-mail: issm_2020@semiconportal.com